



Laser marking

BSP PICO

Pikosaniye üreteçli lazer markalama ve gravürleme sistemi
Laser marking and engraving system with picosecond laser source

Pikosaniye lazer üretici

Bu tür bir üretici, doğrusal olmayan/multifoton emiliminin gerçekleşeceği kadar yüksek tepe yoğunluklarına sahip, yalnızca birkaç pikosaniye süren darbeler üretir: sonuç, çok azaltılmış termal etkiye sahip bir işlemdir; yeniden işleme ihtiyaç duymadan hassas, akıcı ve temiz markalamaları gerçekleştirmek için idealdir..

Kompakt sistem

BSP PICO, ağırlığı 20 kg'a kadar olan parçalar için mükemmel proses stabilitesini garanti eden granit çalışma düzlemi sayesinde kompakt ve sağlam bir yapıya sahiptir. Taban yapısı, 50 µm hareket hassasiyetine sahip 3 motorlu eksen, 300 x 300 mm düzleminde strok ve Z eksenini boyunca 300 mm geniş içerir. Döner veya döner devirmeli mil, dinamik ölçüm ve görüntüleme sistemlerigibi bir dizi aksesuarla donatılabilir.

Gelişmiş yazılım

Tamamen SISMA tarafından geliştirilen entegre yazılım, karmaşık işlerde bile dosyaları ve tüm markalama sürecini yönetmek için ideal çözümdür: BSP PICO'nun tüm potansiyelinden tam olarak yararlanmanıza olanak tanır ve hıza göre yüksek düzeyde özelleştirmeyi garanti eder. Operatörün işini kolaylaştırır ve basitleştirir.

Picosecond laser source

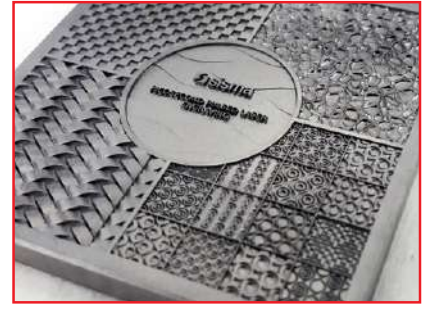
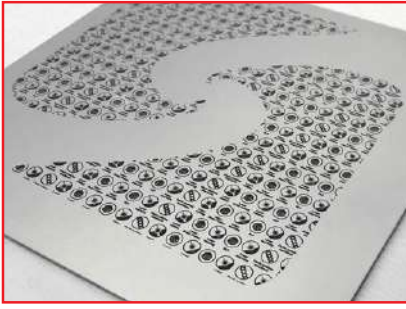
This type of source generates pulses lasting only a few picoseconds with peak intensities so high that non-linear /multiphoton absorption takes place: the result is a process with a very reduced thermal effect, ideal for performing precise, fluid and clean markings without the need to rework the pieces.

Compact system

BSP PICO has a compact and solid structure thanks to the granite working plane that guarantees excellent process stability for pieces up to 20 kg in weight. The base structure includes 3 motorized axes with 50 µm precision of movement, stroke on the plane of 300 x 300 mm and an amplitude along the Z axis of 300 mm. It can be equipped with a series of accessories like the rotating or rotary-tilting spindle, dynamic measuring and vision systems.

Advanced software

Entirely developed by SISMA, the integrated software is the ideal solution for managing files and the entire marking process, even in the case of complex jobs: allowing you to fully exploit all the potential of BSP PICO, it guarantees a high degree of customization to speed up and simplify the operator's work.



Teknik Veri - Technical Data

Aktif malzeme - Active Material	Yb
Ort. güç - Average power	50 W
Dalgaboyu - Wavelength	1030 nm
Frekans - Frequency	50 ÷ 2000 kHz
Darbe süresi - Pulse duration	0,001 - 0,003 ns
Maks. güç - Peak power	10000 kW
Darbe enerjisi - Pulse energy	0,025 mJ
Işın kalitesi - Beam quality (M ²)	< 1,4
Soğutma sistemi - Cooling system	su (taban üzerinde) / water (on the base)
Eksen hareketi (XYZ) - Axis stroke (XYZ)	300 mm x 300 mm x 360 mm
Maks parça ağırlığı - Max piece weight	20 kg
Eksen hassasiyeti - Axis precision	0,05 mm
Eksen tekrarlanabilirliği - Axis repeatability	0,02 mm
Güç kaynağı - Power supply	230 V ± 15% 50/60 Hz - single phase - CEE 16A socket / presa
Güç emilimi - Power absorption	1 kW
Boyutlar (LxDxH) - Dimensions	823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 mm with open door - kapak açık)
Ağırlık - Weight	590 kg

Katalogda yer alan özellikler, görseller, performanslar, ağırlıklar ve ölçüler tamamen gösterge niteliğinde ve yaklaşık olup, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice.